

Dell EMC PowerEdge C6520

Caractéristiques techniques

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : ATTENTION vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

Table des matières

Chapitre 1: Caractéristiques techniques	4
Dimensions du traîneau.....	4
Poids du boîtier.....	5
Spécifications du processeur.....	5
Spécifications des blocs d'alimentation (PSU).....	5
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	6
Spécifications de la batterie du système.....	6
Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension.....	6
Spécifications de la mémoire.....	6
Disques.....	7
Caractéristiques du stockage.....	7
Spécifications des ports et connecteurs.....	8
Caractéristiques du port USB.....	8
Caractéristiques du port d'affichage.....	8
Caractéristiques du port NIC.....	8
Caractéristiques techniques du port iDRAC9.....	8
Caractéristiques vidéo.....	9
Spécifications environnementales.....	9
Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse.....	10
Restrictions thermiques.....	11

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques et environnementales de votre système sont énoncées dans cette section.

Sujets :

- Dimensions du traîneau
- Poids du boîtier
- Spécifications du processeur
- Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)
- Systèmes d'exploitation pris en charge
- Spécifications de la batterie du système
- Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension
- Spécifications de la mémoire
- Disques
- Caractéristiques du stockage
- Spécifications des ports et connecteurs
- Caractéristiques vidéo
- Spécifications environnementales

Dimensions du traîneau

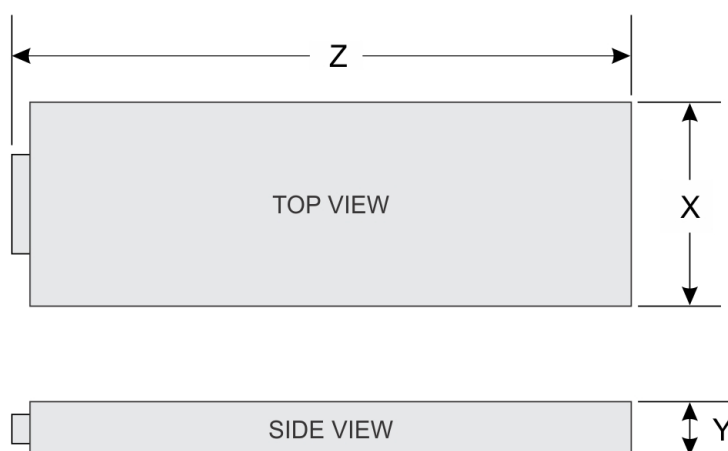


Figure 1. Dimensions du traîneau

Tableau 1. Dimensions du traîneau PowerEdge C6520

X	Y	Z
447,04 mm (17,6 pouces)	86,36 mm (3,4 pouces)	802,64 mm (31,6 pouces)

Poids du boîtier

Tableau 2. Poids du boîtier du boîtier avec traîneaux PowerEdge C6520.

Configuration du système	Poids maximal (avec tous les traîneaux et disques)
12 disques de 3,5 pouces	45,6 kg (100,53 lb)
24 disques de 2,5 pouces	41,4 kg (91,27 lb)
Système sans fond de panier	35 kg (77,16 lb)

Spécifications du processeur

Tableau 3. Spécifications des processeurs du système PowerEdge C6520

Processeur pris en charge	Nombre de processeurs pris en charge
Processeurs Intel Xeon Scalable ³ ® génération avec jusqu'à 40 cœurs	Deux

Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)

Le système PowerEdge C6520 prend en charge jusqu'à deux blocs d'alimentation secteur :

Tableau 4. Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)

Bloc d'alimentation	Classe	Dissipation thermique (maximale)	Fréquence	Tension	CA		Courant
					Ligne haute	Basse tension 100–120 V	
2 600 W	Platinum Platinum	9 750 BTU/h	50/60 Hz	100 à 240 V, sélection automatique	2 600 W(220 - 240 V)	1 400 W	16 A
2 400 W	Platinum	9 000 BTU/h	50/60 Hz	100 à 240 V, sélection automatique	2 400 W(200 - 240 V)	1 400 W	16 A
2 000 W	Platinum	7 500 BTU/h	50/60 Hz	100 à 240 V, sélection automatique	2 000 W(200 - 240 V)	1 000 W	11,5 A
1600 W	Platinum	6 000 BTU/h	50/60 Hz	100 à 240 V, sélection automatique	1600 W(200 - 240 V)	800 W	10 A

- REMARQUE :** Le bloc d'alimentation de 2 600 W avec le numéro de référence 9D4R6 prend uniquement en charge le cordon d'adaptateur C14-C19.
- REMARQUE :** Ce système est également conçu pour se connecter aux systèmes d'alimentation informatiques avec une tension phase à phase ne dépassant pas 240 V.
- REMARQUE :** La dissipation thermique est calculée à partir de la puissance nominale du bloc d'alimentation.
- REMARQUE :** Lorsque vous sélectionnez ou mettez à niveau la configuration du système, vérifiez sa consommation électrique avec Dell Energy Smart Solution Advisor disponible sur [Dell.com/ESSA](https://www.dell.com/ESSA) pour assurer une utilisation optimale de l'alimentation.

Systemes d'exploitation pris en charge

Le systeme PowerEdge C6520 prend en charge les systemes d'exploitation suivants :

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Hyperviseur Citrix
- Microsoft Windows Server avec Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi/vSAN
- CentOS
- Pilotes de l'environnement de preinstallation Windows (WinPE) 64 bits

Pour plus d'informations, consultez www.dell.com/ossupport.

Specifications de la batterie du systeme

Le PowerEdge C6520 systeme prend en charge une Pile bouton au lithium CR 2032 (3 V).

Caracteristiques des cartes de montage de cartes d'extension

Le systeme PowerEdge C6520 prend en charge jusqu'à quatre cartes d'extension PCI express (PCIe) Gen 4.

Tableau 5. Logements de carte d'extension pris en charge sur la carte systeme

Logement PCIe	Cartes de montage	Largeur de la carte de montage	Hauteur du logement PCIe	Longueur du logement PCIe	Largeur du logement PCIe
Logement 1	Carte de montage 1a	PCIe x16	Profil bas	Demi-longueur	x8
Logement 1	Carte de montage 1b avec prise en charge du module d'E/S de SNAP	PCIe x16	Profil bas	Demi-longueur	x8 + x8
Logement 2	Carte de montage 2b	PCIe x16	Profil bas	Demi-longueur	x8

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les consignes d'installation des cartes d'extension, reportez-vous à la section *Manuel d'installation et de maintenance* disponible à l'adresse <https://www.dell.com/poweredgemanuals> de votre systeme.

Specifications de la memoire

Le systeme PowerEdge C6520 prend en charge les specifications de memoire suivantes pour un fonctionnement optimal.

Tableau 6. Specifications de la memoire

Type de module DIMM	Rangée DIMM	Capacité DIMM	Monoprocasseur		Doubles processeurs	
			Capacité minimale du systeme	Capacité maximale du systeme	Capacité minimale du systeme	Capacité maximale du systeme
RDIMM	Une rangée	8 Go	8 Go	64 Go	16 Go	128 Go
	Double rangée	16 Go	16 Go	128 Go	32 Go	256 Go
		32 Go	32 Go	256 Go	64 Go	512 Go
		64 Go	64 Go	512 Go	128 Go	1 To

Tableau 6. Spécifications de la mémoire (suite)

Type de module DIMM	Rangée DIMM	Capacité DIMM	Monoprocasseur		Doubles processeurs	
			Capacité minimale du système	Capacité maximale du système	Capacité minimale du système	Capacité maximale du système
LRDIMM	Quatre rangées	64 Go	64 Go	512 Go	128 Go	1 To
		128 Go	128 Go	1 To	256 Go	2 To

Tableau 7. Sockets de module de mémoire

Sockets de module de mémoire	Vitesse
16 à 288 broches	3 200 MT/s, 2 933 MT/s, 2 666 MT/s

Disques

Le système PowerEdge C6520 prend en charge :

- 12 disques de 3,5 pouces SAS/SATA de 3,5 pouces
- 24 disques de 2,5 pouces SAS/SATA/NVMe de 2,5 pouces

Tableau 8. Options du nombre de disques pris en charge par le traîneau PowerEdge C6520

Nombre maximal de disques dans le traîneau	Nombre maximal de disques attribués par traîneau
Systèmes à 12 disques de 3,5 pouces	Trois disques SAS ou SATA, et Disques SSD SATA par traîneau
Configuration à 24 disques de 2,5 pouces non NVMe	Six disques SAS ou SATA, et Disques SSD SATA par traîneau
Configuration à 8 disques NVMe de 2,5 pouces (2 disques NVMe par traîneau/8 disques NVMe par boîtier)	Le fond de panier NVMe prend en charge les configurations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Deux disques NVMe et quatre disques SAS ou SATA et Disques SSD SATA par traîneau REMARQUE : Les disques NVMe sont limités à la vitesse PCIe Gen 3. <ul style="list-style-type: none"> • Six disques SAS ou SATA, et Disques SSD SATA par traîneau
Configuration à 24 disques de 2,5 pouces NVMe	Six disques NVMe par traîneau
Disque SATA M.2 (en option)	La capacité maximale de la carte SATA M.2 prise en charge est de 960 Go. REMARQUE : La carte SATA M.2 peut être installée sur la carte de montage M.2 ou sur la carte BOSS.
Carte microSD (en option) pour l'amorçage (jusqu'à 64 Go)	Un sur la Carte de montage 1a

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'échange à chaud des disques SSD NVMe PCIe U.2, voir le *Guide de l'utilisateur des disques SSD Dell Express Flash NVMe PCIe* à l'adresse <https://www.dell.com/support> **Parcourir tous les produits > Infrastructure de datacenter > Adaptateurs et contrôleurs de stockage > Disques SSD Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe > Documentation > Manuels et documents.**

Caractéristiques du stockage

Le traîneau PowerEdge C6520 prend en charge :

Tableau 9. Cartes contrôleur de stockage du système


Contrôleurs internes	Contrôleurs externes :
<ul style="list-style-type: none"> • PERC H745 	<ul style="list-style-type: none"> • SAS ext. 12 Gbit/s HBA

Tableau 9. Cartes contrôleur de stockage du système

Contrôleurs internes	Contrôleurs externes :
<ul style="list-style-type: none"> • HBA355i • HBA345 • S150 • H345 • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1) : 2 SSD M.2 HWRAID • H350 • H750 	

Tableau 10. Options RAID prises en charge avec les disques SATA M.2

Options	Un seul disque SATA M.2 sans système RAID	Deux disques SATA M.2 avec RAID matériel
RAID matériel	Non	Oui
Mode RAID	s.o.	RAID 1, RAID 0
Nombre de disques pris en charge	1	2
Processeurs pris en charge	Processeur 1	Processeur 1

 **REMARQUE** : Les options RAID ne sont prises en charge que sur les cartes BOSS qui prennent en charge deux disques SATA M.2.

Spécifications des ports et connecteurs

Caractéristiques du port USB

Le traîneau PowerEdge C6520 prend en charge un USB 3.0 à l'arrière du système.

Caractéristiques du port d'affichage

Le traîneau PowerEdge C6520 prend en charge 1 port Mini DisplayPort .

Caractéristiques du port NIC

Le traîneau PowerEdge C6520 prend en charge jusqu'à un port de contrôleur d'interface réseau (NIC) 10/100/1000 Mb/s intégrés au LAN sur la carte mère (LOM) et intégrés aux cartes OCP (Open Compute Project), en option.

Tableau 11. Caractéristiques du port NIC pour le traîneau

Fonctionnalité	Spécifications
carte LOM	1 GbE
Carte OCP 3.0	4 x 1 GbE, 2 x 10 GbE, 2 x 25 GbE, 4 x 25 GbE

Caractéristiques techniques du port iDRAC9

Le traîneau PowerEdge C6520 prend en charge Un port iDRAC Direct (USB micro-AB) qui se trouve à l'arrière du système.

Caractéristiques vidéo

Le système PowerEdge C6520 prend en charge le contrôleur graphique Matrox G200 intégré avec 16 Mo de mémoire tampon vidéo.

Tableau 12. Options de résolution vidéo avant prises en charge par le système

Résolution	Taux d'actualisation (Hz)	Profondeur de couleur (bits)
1 024 x 768	60	8, 16, 32
1 280 x 800	60	8, 16, 32
1 280 x 1 024	60	8, 16, 32
1 360 x 768	60	8, 16, 32
1 440 x 900	60	8, 16, 32
1 600 x 900	60	8, 16, 32
1 600 x 1 200	60	8, 16, 32
1 680 x 1 050	60	8, 16, 32
1 920 x 1 080	60	8, 16, 32
1 920 x 1 200	60	8, 16, 32

Spécifications environnementales

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les certifications environnementales, veuillez consulter la *fiche technique environnementale du produit* qui se trouve dans la section Documentation sur www.dell.com/support/home.

Tableau 13. Plages climatiques opérationnelles de catégorie A3

Température	Spécifications
Opérations continues autorisées	
Plages de températures pour une altitude ≤ à 900 mètres (≤ à 2 953 pieds)	De 5 à 40 °C (41 à 104 °F) sans lumière solaire directe sur l'équipement
Plages de taux d'humidité (sans condensation permanente)	De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C, à 85% d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 24°C (75,2°F)
Déclassement de l'altitude opérationnelle	La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (33,8 °F/574 pieds) au-dessus de 900 m (2 953 pieds)

Tableau 14. Exigences partagées par toutes les catégories

Température	Spécifications
Opérations continues autorisées	
Gradient de température maximal (s'applique en et hors fonctionnement)	20 °C en une heure* (36 °F en une heure) et 5 °C en 15 minutes (41 °F en 15 minutes), 5 °C en une heure* (41 °F en une heure*) pour les bandes REMARQUE : * Selon les consignes thermiques de l'ASHRAE pour le matériel de bande, il ne s'agit pas de taux instantanés de variation de la température.
Limites de température hors fonctionnement	-40 °C à 65 °C (-104 °F à 149 °F)
Limites d'humidité hors fonctionnement	5 % à 95 % d'humidité relative et point de condensation maximal de 27°C (80,6°F)
Altitude hors fonctionnement maximale	12 000 mètres (39 370 pieds)

Tableau 14. Exigences partagées par toutes les catégories (suite)

Température	Spécifications
Altitude de fonctionnement maximale	3 048 mètres (10 000 pieds)

Caractéristiques de vibration maximale

Tableau 15. Caractéristiques de vibration maximale

Vibration maximale	Spécifications
En fonctionnement	0,26 Grms de 5 à 350 Hz (toutes orientations de fonctionnement).
Stockage	1,88 Grms de 10 Hz à 500 Hz pendant 15 minutes (les six côtés testés).

Spécifications d'onde de choc maximale

Tableau 16. Caractéristiques de choc maximal

Choc maximal	Spécifications
En fonctionnement	Six impulsions de chocs consécutifs de 6 G en positif et négatif sur les axes x, y et z pendant un maximum de 11 ms (quatre impulsions de chaque côté du système).
Stockage	Six chocs consécutifs de 71 G en positif et en négatif sur les axes x, y et z durant 2 ms au maximum (une impulsion de chaque côté du système).

Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse

Le tableau suivant définit les limitations qui permettent d'éviter les dommages et/ou les pannes d'équipement informatique causés par une contamination particulaire ou gazeuse. Si les niveaux de contamination particulaire ou gazeuse dépassent les limites indiquées et causent des dommages ou une panne d'équipement, vous devez rectifier les conditions environnementales. La modification de ces conditions environnementales relève de la responsabilité du client.

Tableau 17. Caractéristiques de contamination particulaire

Contamination particulaire	Spécifications
Filtration de l'air	Filtration de l'air du datacenter telle que définie par l'ISO Classe 8 d'après la norme ISO 14644-1, avec une limite de confiance maximale de 95 %. <i>i</i> REMARQUE : Cette condition s'applique uniquement aux environnements de datacenter. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un datacenter, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine. <i>i</i> REMARQUE : L'air qui entre dans le datacenter doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.
Poussières conductrices	L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices. <i>i</i> REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.
Poussières corrosives	<ul style="list-style-type: none"> L'air doit être dépourvu de poussières corrosives. Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60 %.

Tableau 17. Caractéristiques de contamination particulaire (suite)

Contamination particulaire	Spécifications
	REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.

Tableau 18. Caractéristiques de contamination gazeuse

Contamination gazeuse	Spécifications
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre	<300 Å/mois selon la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-2013
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent	< à 200 Å/mois conformément à la norme ANSI/ISA71.04-2013.

REMARQUE : Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50% d'humidité relative.

Restrictions thermiques

REMARQUE :

1. Non disponible : indique que la configuration n'est pas proposée par Dell EMC.
2. Non pris en charge : indique que la configuration n'est pas prise en charge thermiquement.

REMARQUE : Tous les composants, y compris les barrettes DIMM, les cartes de communication, ainsi que les cartes SATA M.2 et PERC, peuvent être pris en charge avec suffisamment de marge thermique si la température ambiante est inférieure ou égale à la température de fonctionnement continu maximale indiquée dans ces tableaux.

REMARQUE : Certaines configurations matérielles du système nécessitent une limite de température supérieure réduite. Pour plus d'informations sur les exigences de température de fonctionnement, contactez le support technique.

REMARQUE : Certaines configurations nécessitent une température ambiante inférieure. Pour plus d'informations, consultez les tableaux suivants.

Les tableaux suivants répertorient les restrictions clés de la température ambiante en fonction de la configuration du processeur dans le système. Toutes les températures d'entrée fournies ci-dessous sont en degrés Celsius continus.

Tableau 19. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques Direct de 2,5 pouces/de disques NVMe de 2,5 pouces (à refroidissement par air)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/ traîneau	4 disques/ traîneau	2 disques/ traîneau	1 disque/ traîneau	Sans fond de panier
8380	270	40	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8368	270	38	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8368Q	270	38	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8 362	265	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8360Y	250	36	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8358	250	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8358P	240	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20
6348	235	28	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20

Tableau 19. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques Direct de 2,5 pouces/de disques NVMe de 2,5 pouces (à refroidissement par air) (suite)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/ traîneau	4 disques/ traîneau	2 disques/ traîneau	1 disque/ traîneau	Sans fond de panier
6342	230	24	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20	20
8352Y	205	32	20	20	25	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25	25
6338	205	32	20	20	25	25	25
6330	205	28	20	20	25	25	25
6354	205	18	Non pris en charge	20	20	20	25
6346	205	16	Non pris en charge	20	20	20	25
8352V	195	36	20	20	25	25	25
8352M	185	32	20*	20*	25	25	25
6338N	185	32	20*	20*	25	25	25
5320	185	26	20*	20*	25	25	25
6336Y	185	24	20*	20*	25	25	25
6326	185	16	20*	20*	25	25	25
6330N	165	28	25	25*	25*	25*	25*
6338T	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318Y	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318S	165	24	25	25*	25*	25*	25*
6334	165	8	25	25*	25*	25*	25*
5318N	150	24	25*	30	30	30	30*
5320T	150	20	25*	30	30	30	30*
4316	150	20	25*	30	30	30	30*
5317	150	12	25*	30	30	30	30*
5315Y	140	8	30	30	30*	30*	30*
4314	135	16	30*	30*	30*	30*	30*
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

i REMARQUE :

- Les données suivies d'une * signifient qu'il peut y avoir un décalage de température de +5°C si vous utilisez le processeur 1 étendu avec dissipateur de chaleur dans cette configuration.
- H745 n'est pas pris en charge avec le processeur TDP > 185 W.
- Des restrictions thermiques supplémentaires sont requises pour une configuration avec PCIE > 25 watts, des barrettes LRDIMM de 128 Go et un processeur graphique.

Tableau 20. Température de fonctionnement continu maximale pour processeur unique avec configuration de disques direct de 2,5 pouces pour le processeur 1 (à refroidissement par air)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/ traîneau	4 disques/ traîneau	2 disques/ traîneau	1 disque/traîneau	Sans fond de panier
8380	270	40	20	20	20	20	25
8368	270	38	20	20	25	25	25
8368Q	270	38	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8362	265	32	20	20	25	25	25
8360Y	250	36	20	20	25	25	25
8358	250	32	20	20	25	25	25
8358P	240	32	20	20	25	25	25
6348	235	28	25	25	25	25	30
6342	230	24	25	25	25	25	30
8351N	225	36	20	20	25	25	25
8352Y	205	32	30	30	35	35	35
6314U	205	32	30	30	35	35	35
8352S	205	32	30	30	35	35	35
6338	205	32	30	30	35	35	35
6330	205	28	30	30	35	35	35
6354	205	18	25	25	30	30	30
6346	205	16	25	25	30	30	30
8352V	195	36	30	30	30	30	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6312U	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35

Tableau 20. Température de fonctionnement continu maximale pour processeur unique avec configuration de disques direct de 2,5 pouces pour le processeur 1 (à refroidissement par air) (suite)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/ traîneau	4 disques/ traîneau	2 disques/ traîneau	1 disque/traîneau	Sans fond de panier
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

REMARQUE : Des restrictions thermiques supplémentaires sont requises pour une configuration avec PCIE > 25 watts, des barrettes LRDIMM de 128 Go et un processeur graphique.

Tableau 21. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques NVMe de 2,5 pouces (à refroidissement à air)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/ traîneau	4 disques/traîneau	2 disques/traîneau	1 disque/ traîneau
8380	270	40	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8368	270	38	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8368Q	270	38	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8 362	265	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8360Y	250	36	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8358	250	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8358P	240	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6348	235	28	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6342	230	24	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20
8352Y	205	32	20	20	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25
6338	205	32	20	20	25	25
6330	205	28	20	20	25	25
6354	205	18	Non pris en charge	Non pris en charge	20	20
6346	205	16	Non pris en charge	Non pris en charge	20	20
8352V	195	36	20	20	25	25
8352M	185	32	20	20	25	25
6338N	185	32	20	20	25	25
5320	185	26	20	20	25	25
6336Y	185	24	20	20	25	25
6326	185	16	20	20	25	25
6330N	165	28	20*	20*	25*	25*
6338T	165	24	20*	20*	25*	25*

Tableau 21. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques NVMe de 2,5 pouces (à refroidissement à air) (suite)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/ traîneau	4 disques/traîneau	2 disques/traîneau	1 disque/ traîneau
5318Y	165	24	20*	20*	25*	25*
5318S	165	24	20*	20*	25*	25*
6334	165	8	20*	20*	25*	25*
5318N	150	24	25	25	30	30
5320T	150	20	25	25	30	30
4316	150	20	25	25	30	30
5317	150	12	25	25	30	30
5315Y	140	8	25*	25*	30*	30*
4314	135	16	25*	25*	30*	30*
4310	120	12	30	30	35	35
4310T	105	10	30*	30*	35	35
4309Y	105	8	30*	30*	35	35

Tableau 22. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques direct de 3,5 pouces (à refroidissement par air)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	3 disques/traîneau	2 disques/traîneau	1 disque/traîneau
8380	270	40	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8368	270	38	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8368Q	270	38	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8 362	265	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8360Y	250	36	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8358	250	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8358P	240	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6348	235	28	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6342	230	24	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8351N	225	36	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8352Y	205	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6314U	205	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8352S	205	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6338	205	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6330	205	28	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6354	205	18	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6346	205	16	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8352V	195	36	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8352M	185	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6338N	185	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
5320	185	26	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

Tableau 22. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques direct de 3,5 pouces (à refroidissement par air) (suite)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	3 disques/traîneau	2 disques/traîneau	1 disque/traîneau
6336Y	185	24	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6312U	185	24	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6326	185	16	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
6330N	165	28	Non pris en charge	Non pris en charge	20
6338T	165	24	Non pris en charge	Non pris en charge	20
5318Y	165	24	Non pris en charge	Non pris en charge	20
5318S	165	24	Non pris en charge	Non pris en charge	20
6334	165	8	Non pris en charge	Non pris en charge	20
5318N	150	24	Non pris en charge	Non pris en charge	20
5320T	150	20	Non pris en charge	Non pris en charge	20
4316	150	20	Non pris en charge	Non pris en charge	20
5317	150	12	Non pris en charge	Non pris en charge	20
5315Y	140	8	Non pris en charge	20	20*
4314	135	16	Non pris en charge	20*	20*
4310	120	12	20	25	25
4310T	105	10	25	30	30
4309Y	105	8	25	30	30

Tableau 23. Température de fonctionnement continu maximale pour processeur unique avec configuration de disques direct de 3,5 pouces (à refroidissement par air)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	3 disques/traîneau	2 disques/traîneau	1 disque/traîneau
8380	270	40	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8368	270	38	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8368Q	270	38	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8 362	265	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8360Y	250	36	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8358	250	32	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
8358P	240	32	Non pris en charge	Non pris en charge	20
6348	235	28	Non pris en charge	20	20
6342	230	24	Non pris en charge	20	20
8351N	225	36	Non pris en charge	Non pris en charge	20
8352Y	205	32	20	25	25
6314U	205	32	20	25	25
8352S	205	32	20	25	25
6338	205	32	20	25	25
6330	205	28	20	25	25
6354	205	18	Non pris en charge	20	25
6346	205	16	Non pris en charge	20	25

Tableau 23. Température de fonctionnement continu maximale pour processeur unique avec configuration de disques direct de 3,5 pouces (à refroidissement par air) (suite)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	3 disques/traîneau	2 disques/traîneau	1 disque/traîneau
8352V	195	36	20	25	25
8352M	185	32	25	30	30
6338N	185	32	25	30	30
5320	185	26	25	30	30
6336Y	185	24	25	30	30
6312U	185	24	25	30	30
6326	185	16	25	30	30
6330N	165	28	25	30	30
6338T	165	24	25	30	30
5318Y	165	24	25	30	30
5318S	165	24	25	30	30
6334	165	8	25	30	30
5318N	150	24	30	35	35
5320T	150	20	30	35	35
4316	150	20	30	35	35
5317	150	12	30	35	35
5315Y	140	8	30	35	35
4314	135	16	30	35	35
4310	120	12	30	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

Tableau 24. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques Direct de 2,5 pouces/de disques NVMe de 2,5 pouces (à refroidissement liquide)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/traîneau	4 disques/traîneau	2 disques/traîneau	1 disque/traîneau	Sans fond de panier
8380	270	40	35	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35	35
8 362	265	32	35	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35	35

Tableau 24. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques Direct de 2,5 pouces/de disques NVMe de 2,5 pouces (à refroidissement liquide) (suite)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/ traîneau	4 disques/ traîneau	2 disques/ traîneau	1 disque/ traîneau	Sans fond de panier
6330	205	28	35	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

REMARQUE : Des restrictions thermiques supplémentaires sont requises pour une configuration avec PCIE > 25 watts, des barrettes LRDIMM de 128 Go et un processeur graphique.

Tableau 25. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques NVMe de 2,5 pouces (à refroidissement liquide)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/ traîneau	4 disques/ traîneau	2 disques/ traîneau	1 disque/traîneau
8380	270	40	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35
8 362	265	32	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35

Tableau 25. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques NVMe de 2,5 pouces (à refroidissement liquide) (suite)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	6 disques/ traîneau	4 disques/ traîneau	2 disques/ traîneau	1 disque/traîneau
6342	230	24	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35

REMARQUE : Des restrictions thermiques supplémentaires sont requises pour une configuration avec PCIE > 25 watts, des barrettes LRDIMM de 128 Go et un processeur graphique.

Tableau 26. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques Direct de 3,5 pouces (à refroidissement liquide)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	3 disques/traîneau	2 disques/traîneau	1 disque/traîneau
8380	270	40	35	35	35
8368	270	38	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35
8 362	265	32	35	35	35

Tableau 26. Température de fonctionnement continu maximale pour double processeur avec configuration de disques Direct de 3,5 pouces (à refroidissement liquide) (suite)

Processeurs	TDP (W)	Cœurs	3 disques/traîneau	2 disques/traîneau	1 disque/traîneau
8360Y	250	36	35	35	35
8358	250	32	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35
6348	235	28	35	35	35
6342	230	24	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35
6338	205	32	35	35	35
6330	205	28	35	35	35
6354	205	18	35	35	35
6346	205	16	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35
5320	185	26	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35
6326	185	16	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35
6334	165	8	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35
4316	150	20	35	35	35
5317	150	12	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35
4314	135	16	35	35	35
4310	120	12	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

REMARQUE : Des restrictions thermiques supplémentaires sont requises pour une configuration avec PCIe > 25 watts, des barrettes LRDIMM de 128 Go et un processeur graphique.

Restriction de configuration ASHRAE A3

Tableau 27. Restriction de configuration ASHRAE A3

À refroidissement liquide	À refroidissement par air
<ul style="list-style-type: none">• Le disque SSD NVMe n'est pas pris en charge.• Barrette LRDIMM non prise en charge.• Les cartes PCIe d'une puissance supérieure à 25 W ne sont pas prises en charge.• Carte du processeur graphique non prise en charge.• La configuration des disques de 3,5 pouces n'est pas prise en charge.	<ul style="list-style-type: none">• Le disque SSD NVMe n'est pas pris en charge.• Barrette LRDIMM non prise en charge.• Les cartes PCIe d'une puissance supérieure à 25 W ne sont pas prises en charge.• Carte du processeur graphique non prise en charge.• La configuration des disques de 3,5 pouces n'est pas prise en charge.• Pour le traîneau 1P, la valeur TDP maximale prise en charge pour le processeur est de 150 W.• Pour le traîneau 2P, la valeur TDP maximale prise en charge pour le processeur est de 105 W.